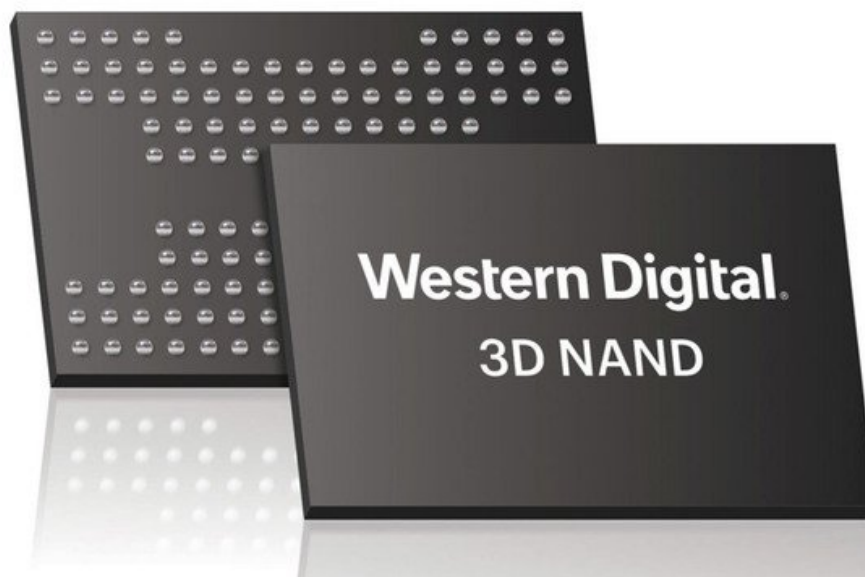


Western Digital anuncia nuevos chips de memoria NAND 3D de 96 capas de tipo QLC, 1.33 Tb



Western Digital ha estado desarrollando nuevos chips de memoria *flash* para las SSD que produce,

aunque lo hace en colaboración con Toshiba utilizando lo que denominan BiCS –un acrónimo del inglés *bit column stacked*, o columnas de bits apiladas–. Es la forma en que tienen estas compañías de llamar a la tecnología de NAND 3D, y en este caso la nueva generación BiCS4 alcanza las 96 capas. Y, más importante, utiliza tecnología QLC o cuatro bits por celda, lo que aumenta sustancialmente la capacidad máxima de cada chip.

En este caso, Western Digital indica que alcanza los 1.33 Tb (166 GB) por chip, que habilitará la creación de SSD de alta capacidad en un espacio mínimo. El problema que tiene la tecnología QLC es que tiene menos margen de degradación del sustrato utilizado durante la grabación de información, por lo

que los ciclos de programación/borrado de estos chips baja a los 1000 ciclos. Está bastante lejos de los 10 000 PE de tecnologías MLC asentadas, o más de 3000 PE de la TLC.

Western Digital ya está probando las muestras de estos chips, y espera que la producción empiece este año, con los primeros productos que la usen poniéndose a la venta bajo la marca SanDisk. BiCS4 es la segunda generación de memoria NAND 3D de tipo QLC de la compañía, siendo la primera la creada con 64 capas llamada BiCS3. Debido a su baja durabilidad, su uso es sobre todo para centros de datos y aplicaciones que hagan sobre todo lectura de disco y no tanto grabación de datos.

Fuente: geektopia.